

【11】證書號數：I784802

【45】公告日：中華民國 111(2022)年 11 月 21 日

【51】Int. Cl.： A01G25/02 (2006.01)

發明

全 4 頁

【54】名稱：滴灌用槽體及其使用方法

【21】申請案號：110142818

【22】申請日：中華民國 110(2021)年 11 月 17 日

【11】公開編號：202222149

【43】公開日期：中華民國 111(2022)年 06 月 16 日

【30】優先權：2020/11/27

中國大陸

202011367398.4

【72】發明人：汪能定(TW) WANG, NENG-TING

【71】申請人：震亞物聯網科技有限公司

臺北市信義區松德路 65 號 11 樓之 2

【74】代理人：彭首席

【56】參考文獻：

TW M624499U

CN 102422769A

CN 103609354A

審查人員：彭裕志

【57】申請專利範圍

1. 一種滴灌用槽體，包括：一底板；二側板分別連接該底板的兩側，與該底板構成一收容空間用於乘載至少一介質；至少一給水槽在水平方向上設置於該側板相對該收容空間的另一側，且該至少一給水槽用於承載至少一液體，每一該至少一給水槽包括在垂直方向上由下而上設置的若干子滴漏區，該若干子滴漏區的最下方的一子滴漏區與該收容空間相通；其中該子滴漏區之外的該若干子滴漏區與該收容空間均不相通。
2. 如請求項 1 所述的滴灌用槽體，其中，該若干子滴漏區還包括若干滴漏層，個別設置在每兩個相鄰的該若干子滴漏區之間，每一該若干滴漏層包括若干孔洞用於通過該至少一液體。
3. 如請求項 1 所述的滴灌用槽體，其中，該若干子滴漏區在垂直方向上的高度不同。
4. 如請求項 2 所述的滴灌用槽體，其中，該些多個子滴漏區的若干孔洞的大小不同。
5. 如請求項 2 所述的滴灌用槽體，其中，每一個該子滴漏區的不同區域的該至少一孔洞的密度不同。
6. 如請求項 5 所述的滴灌用槽體，其中，在垂直方向上由上而下，該多個子滴漏區的該至少一孔洞的密度由小變大。
7. 如請求項 2 所述的滴灌用槽體，其中，在垂直方向上，該最下方的子滴漏區與上一個子滴漏區之間的該若干滴漏層的一滴漏層的相鄰若干孔洞是封閉的，使該至少一液體僅能通過一半的該若干孔洞到達該最下方的子滴漏區。
8. 如請求項 1 所述的滴灌用槽體，其中，該底板、該側板及該至少一給水槽是由紙製品透過淋膜製成。
9. 如請求項 1 所述的滴灌用槽體，其中，一紙板透過凹折工序及熱熔工序而形成該底板、該側板及該至少一給水槽。
10. 一種如請求項 1 所述的滴灌用槽體的使用方法，其中，包括：於一土壤中形成對應該滴灌用槽體形狀的一凹槽；將該滴灌用槽體置入該凹槽；將該至少一介質置入該收容空間；該若干子滴漏區的最上方的一子滴漏區連接該至少一液體；該至少一液體通過該最

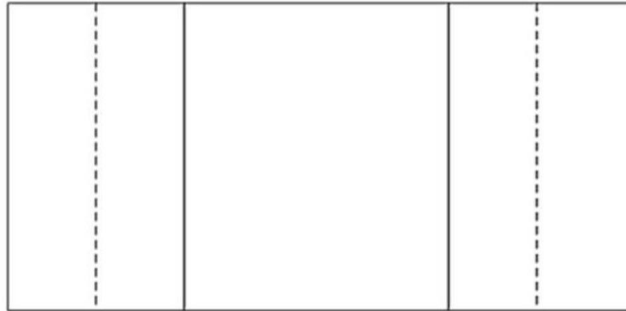
(2)

上方的該子滴漏區依序下降至最下方的一子滴漏區後才輸送至該收容空間接觸該至少一介質；其中該子滴漏區之外的該若干子滴漏區與該收容空間均不相通。

圖式簡單說明

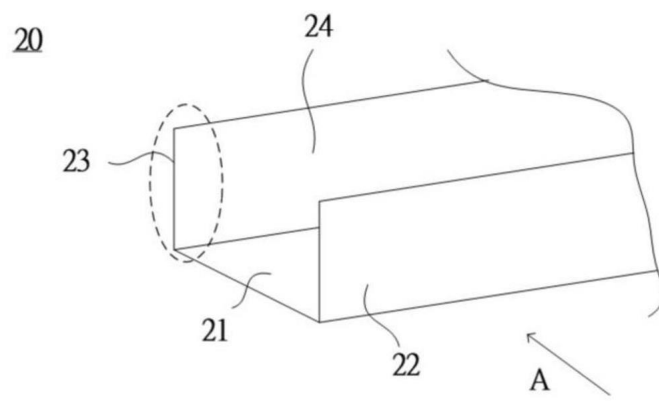
圖 1 繪示一根據本發明的紙板的示意圖；圖 2 繪示一根據本發明的滴灌用槽體的示意圖；圖 3 繪示一根據圖 2 圈選處的放大示意圖；圖 4 繪示一根據圖 2 的一給水槽在箭頭 A 方向的剖面示意圖；及圖 5 繪示一根據本發明的滴灌用槽體的使用方法流程圖。

10

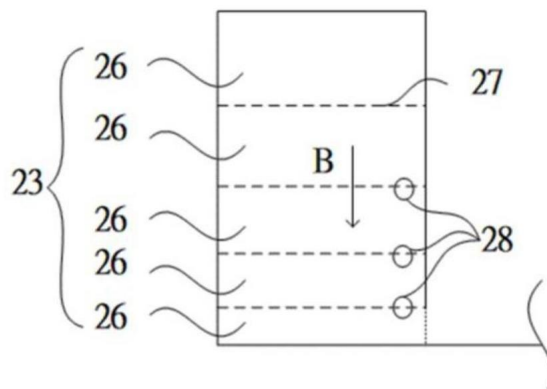


【圖1】

(3)

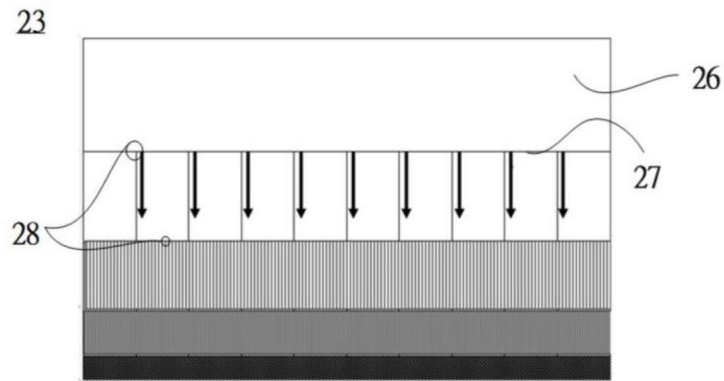


【圖2】

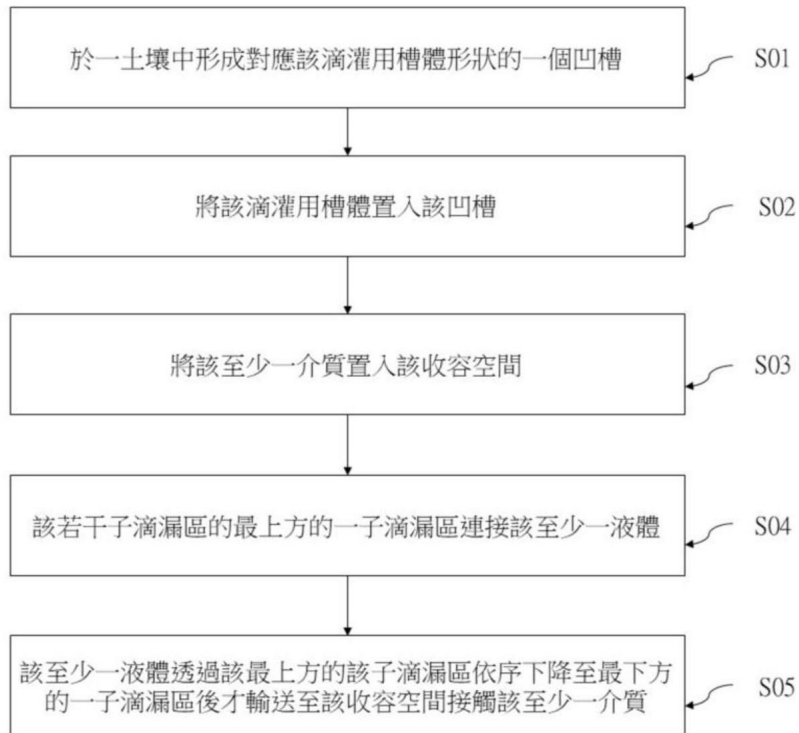


【圖3】

(4)



【圖4】



【圖5】